

Prova orale: Domanda 1

1. Descrivere brevemente il processo di wire bonding.
2. Descrivere l'impostazione di un foglio di carico-scarico di reagenti chimici mediante il programma EXCEL
3. Leggere e tradurre il seguente brano:

Back end of line

The back end of line (BEOL) is the second portion of IC fabrication where the individual devices (transistors, capacitors, resistors, etc.) get interconnected with wiring on the wafer, the metalization layer. Common metals are copper and aluminum.